



平成 29 年 5 月 8 日

各 位

会社名 内外テック株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎  
 (JASDAQ・コード3374)  
 問合せ先 取締役 佐々木 政彦  
 電 話 03-5433-1123(代表)

## 平成 29 年 3 月期の業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年11月11日に公表しました平成29年3月期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の通期業績予想及び平成28年5月23日に公表しました期末配当予想の修正を決議しましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 業績予想の修正について

(1) 平成29年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 19,584	百万円 631	百万円 601	百万円 403	円 銭 166.04
今回修正予想(B)	20,918	874	849	626	257.83
増減額(B-A)	1,334	242	247	223	—
増減率(%)	6.8	38.4	41.2	55.2	—
(ご参考)前期実績 (平成28年3月期)	19,531	614	584	444	182.88

※ 当社は平成28年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。平成29年3月期の1株当たり当期純利益は、当該株式併合の影響を考慮しております。

また、前期実績の1株当たり当期純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算定しております。

### (2) 修正の理由

当社グループの業績に大きな影響を与える半導体・半導体製造装置市場では、スマートフォンを中心とするモバイル機器の高機能化や、IoT市場の拡大に伴うデータセンター向けサーバーの高集積化などによる半導体の需要増が見込まれております。これらを背景に、半導体メーカーによるロジック半導体や3D NAND型フラッシュメモリなど先端技術への設備投資に加え、生産力拡大に向けた設備投資などが活発に行われたことから、半導体製造装置メーカーの受注は好調に推移しました。

また、FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置市場では、中国、韓国を中心とした、モバイル用途の中小型パネル向けの設備投資や大型液晶パネル向け設備投資が着実に拡大したことから、FPD製造装置メーカーの受注は堅調に推移しました。

この結果、通期連結業績予想は、主要取引先である半導体製造装置メーカーからの受注が堅調に推移したことから、売上高 209 億 18 百万円（前年同期比 7.1%増）、営業利益 8 億 74 百万円（前年同期比 42.2%増）、経常利益 8 億 49 百万円（前年同期比 45.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益 6 億 26 百万円（前年同期比 41.0%増）にそれぞれ上方修正が見込まれます。

## 2. 配当予想の修正について

### (1) 配当予想修正の内容（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想 (平成28年5月23日発表)	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 10.00	円 銭 10.00
今 回 修 正 予 想	—	0.00	—	20.00	20.00
当 期 実 績	—	—	—	—	—
前 期 実 績 (平成28年3月期)	—	0.00	—	5.00	5.00

※ 当社は平成28年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。平成29年3月期（予想）の1株当たり期末配当金は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。

また、平成28年3月期の1株当たり配当金については株式併合前の実際の配当額を記載しております。

### (2) 修正の理由

当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続することを基本とし、当該事業年度の業績、財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案することを基本方針としております。

この基本方針のもと平成29年3月期連結業績・今後の業績見込等を勘案し、1株当たりの期末配当予想を平成28年5月23日に公表しました10円に、10円を上乗せし、1株当たり20円に修正いたします。

(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

以 上